

证券代码：002008

证券简称：大族激光

大族激光科技产业集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025007

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☒ 现场参观 ☒ 其他（电话会议） ☒ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动	
参与单位名称 及人员姓名	中金公司（7月2日） 招商证券（7月2日） 财通证券（7月4日） 润晖投资（7月9日） 美银美林（7月9日） 富国基金（7月14日） 高盛证券（7月15日） UBS（7月15日） 花旗银行（7月15日） 摩根资产管理（7月15日） 华安证券（7月15日） 信达证券（7月15日） 摩根士丹利（7月16日） 百年保险（7月17日） 中邮证券（7月22日） 景顺长城（7月24日） 汇丰银行（7月25日）	
时间	2025年7月2日~2025年7月31日	
地点	公司会议室	
上市公司 接待人员姓名	管理与决策委员会副主任、董事会秘书 杜永刚 证券事务代表 王琳	
投资者关系活动 主要内容介绍	一、公司经营情况 今年以来，随着下游行业需求的逐渐恢复，公司经营情况逐步改善。2025年半年度业绩预计实现净利润4.5亿元~5亿元，同比下降59.18%~63.26%，扣除非经常性损益的净利润2.2亿元~2.65亿元，同比增长0.00%~20.00%。净利润下降主要由于上年同期存在处置持有的大族思特公司股权对归属于上市公司股东的净利润影响约8.90亿元；同时得益于消费类电子市场回暖及叠加AI驱动带来	

的供应链强劲需求，公司信息产业设备市场需求及经营业绩较上年有所增长，故扣除非经常性损益后的净利润随之增长。

二、公司 PCB 业务经营及产品情况

公司控股子公司大族数控（股票代码：301200）2025 年第一季度实现营业收入 9.59 亿元，同比增长 27.89%；实现净利润 1.17 亿元，同比增长 83.60%；扣除非经常性损益的净利润 1.08 亿元，同比增长 90.14%。随着 AI 产业链服务器、高速交换机等基础设施需求爆发，叠加消费电子市场复苏，PCB 专用加工设备市场需求快速反弹。

公司构建了覆盖多层板、HDI 板、IC 封装基板、挠性板及刚挠结合板等不同细分 PCB 市场及层压、钻孔、曝光、成型、检测等关键工序的立体化产品矩阵，为 PCB 不同细分领域的客户提供差异化的一站式工序解决方案。2024 年，公司不断完善各类型产品线布局并提升竞争能力，进一步丰富产品矩阵内涵，压合系统、十二轴自动化机械钻孔机、自动上下料机械成型机、四光束 CO₂ 激光钻孔机、新型激光加工设备、玻璃基板 TGV 成套设备等行业创新型产品获得客户认可，全部达到批量市场推广水平，部分产品已经实现大批量订单。针对行业发展快速的 AI 服务器高多层板，提供包括高精度通孔、盲孔、背钻加工设备，高解析度及层间对准度激光成像系统、高精密质量检测设备等，满足该类高速 PCB 更高信号完整性加工需求，赋能行业技术升级。

三、公司新能源领域业务情况

锂电设备行业的增长重点逐步由国内转向海外，公司在深化大客户合作的同时，积极拓展海外市场业务。公司持续推进与宁德时代、中创新航、亿纬锂能、欣旺达、海辰储能、蜂巢能源等行业主流客户的合作，积极参与到大客户出海的进程中，抓住新能源市场发展的全球化发展机遇，进一步提升动力电池和储能电池装备业务的市场竞争力和市场占有率，并通过加强创新技术研发和精细化管理等多种方式，持续提升盈利能力。

光伏设备方面，受行业景气度影响，下游客户资本开支明显减少，对公司相关设备订单造成一定影响。公司在主流电池厂家取得主制程设备（PECVD、LPCVD、硼扩散炉、退火炉等）批量订单，并与主流客户共同开发验证电池生

产工序核心装备。同时，公司加快海外业务的拓展步伐，中标客户在老挝等地订单。在钙钛矿技术领域，公司持续优化钙钛矿激光刻划相关设备工艺及性能，在该细分领域市场占有率处于领先地位，与极电光能、协鑫光电等行业头部客户保持良好合作关系。

四、通用工业激光加工设备市场复苏情况

随着激光切割行业竞争激烈，市场格局日新月异。面对外部复杂环境，公司坚持研发创新，紧密围绕客户及市场需求，不断优化升级产品；坚持爆品打造，实现产品的大规模市场推广与销售放量；同时，严格坚守质量底线，坚持以质量为本。公司自主研发的三维五轴切割头取得突破，首年销售额突破 5,000 万，实现了广泛的国产替代，普遍应用于汽车行业热成型加工领域。公司推出了全球首台 150KW 超高功率切割机，扩大公司在高端领域的市场影响力。与浙江鼎力、东南网架、中国石油、爱玛科技等客户达成合作，在厚板切割效率、坡口特殊加工工艺等关键技术及超高功率激光切割工艺上持续取得进步。另一方面，根据市场需求，加大对中低端市场的覆盖和拓展，高功率激光切割设备整体市占率稳步提升。

五、公司海外布局发展情况

当前，制造业供应链产地已经呈现多元化的发展趋势，东南亚地区设备需求呈明显上升趋势，公司正大力扩充海外研发销售团队人员，紧跟大客户的步伐，抓住供应链多元化带来的市场机会。在 PCB 海外市场方面，由于国际电子终端品牌加速供应链多元化，泰国、越南等东南亚国家 PCB 产业投资项目纷纷投产，预测未来几年的复合成长率将超过中国大陆。随着产业链的重构，美国、欧洲等地区为服务当地半导体产业发展，将全新构建当地的供应体系，其 IC 封装基板未来五年的复合增长率分别高达 18.3% 及 40.6%。

六、公司回购完成及注销情况

公司于 2025 年 2 月 6 日披露《关于回购公司股份方案实施完成暨股份变动的公告》，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 22,589,592 股，占公司总股本的比例为 2.15%，支付的资金总额为人民币 500,244,727.76 元（不含交易费用）。本次回购已实施完毕，实际回购股份时间区

	间为 2024 年 2 月 6 日至 2025 年 1 月 10 日。 公司于 2025 年 5 月 13 日披露《注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股权益，进一步增强投资者信心，根据公司实际经营情况，结合公司整体战略规划、价值持续增长等因素综合考量，经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司股份回购专户中的 22,589,592 股，由原计划“用于后续实施员工持股计划或股权激励”及“用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）”变更为“用于注销以减少注册资本”，注销事宜已于 2025 年 7 月 1 日办理完成，并于 2025 年 7 月 3 日公告，公司最新总股本为 1,029,603,408 股。 七、公司质押情况 目前，公司实际控制人及控股股东持有股份质押比例为 79.89%。
附件清单 (如有)	
日期	2025 年 7 月 31 日